

**Zeitschrift:** Comtec : Informations- und Telekommunikationstechnologie = information and telecommunication technology  
**Herausgeber:** Swisscom  
**Band:** 79 (2001)  
**Heft:** 9  
  
**Rubrik:** Forschung und Entwicklung

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 10.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



### Einheitlicher Messaging-Standard

Nokia, Ericsson und Motorola haben gemeinsam eine Initiative für einen mobilen Instant-Messaging-Standard, Wireless Village, ins Leben gerufen. Dieser soll die Spezifikationen für den Austausch von Nachrichten zwischen den mobilen Geräten, Services und Internet-basierten Instant Messaging Services festlegen. Die Initiative ist nach Angaben der drei Handyhersteller für weitere Teilnehmer offen. Das Protokoll soll auf die Bedürfnisse von Mobilfunknetzen abgestimmt sein. Die geplanten Instant Messaging Services sollen es den Benutzern ermöglichen, mit unterschiedlichen mobilen Endgeräten wie Handys, Pager oder PDAs verschiedenste Nachrichten einschliesslich Multimedia-Inhalte zu senden. Daneben sind Presence Services geplant, die für den Austausch von Informationen über den Status eines Benutzers wie online/offline und Aufenthaltsort bis hin zur augenblicklichen Stimmung genutzt werden können. Schliesslich können Mobilfunkgesellschaften Konferenzschaltungen anbieten. Die drei Handyhersteller sehen Messaging und Presence Services als einen Schlüsselbereich für den Erfolg des mobilen Internets an. Diese Services sollen ausserdem die Einführung von UMTS beschleunigen und neue Einnahmequellen für die Mobilfunkgesellschaften erschliessen. Die Spezifikationen werden auf den bereits bestehenden Protokollen und Standards wie SMS, WAP und XML aufbauen. Der Service wird nach Angaben der drei Unternehmen Sicherheitsfunktionen für die Authentifizierung der Benutzer, sichere Übertragungen und Zugangsprotokolle enthalten. Die Veröffentlichung der Spezifikationen von Wireless Village ist für das Jahresende 2001 auf der Website geplant.

Homepage: [www.wireless-village.org](http://www.wireless-village.org)  
 Homepage: [www.press.nokia.com/PR/200104/817796\\_5.html](http://www.press.nokia.com/PR/200104/817796_5.html)

### Durchbruch bei EUV-Lithografien

Entwicklern von Intel ist nach eigenen Angaben die Herstellung der ersten Fotomaske für Lithografie mit Extrem-Ultraviolett-Licht (EUV) nach Industriestandards gelungen. Solche Masken sind ein Schlüsselement für die Erzeugung von noch kleineren und schnelleren Mikroprozessoren, beginnend mit einer Grösse von 0,07 Micron. Extrem-Ultraviolett-Lithografie gilt als zukünftiger

### ISSE 2001

ISSE 2001 is organised by EEMA, the European Forum for Electronic Business in conjunction with TeleTrust, Association for the Promotion of Trustworthiness in Information and Communication Technology. The event is also supported by the European Commission and German Federal Ministry of Economics and Technology and sponsored by AddTrust, GlobalSign, SAP AG, and Tivoli Systems. Government Ministers, European Commissioners, Leading Technologists, Heads of Industry, and Legal Professionals will present the most recent concerns and solutions in 60 sessions divided into four tracks covering:

- The development of technology
- Infrastructure
- Applications
- The political and legal aspects of information security

As the IT security market is driven by real experiences the information within the conference mirrors this and is presented through case studies, best practice and real life experiences. With IT security seen as one of the major factors to the success and growth of e-business, ISSE has a considerable role to play in informing organisations of the issues and solutions to enable them to have a secure ICT infrastructure and benefit from the e-business revolution.

Information Security Solutions Europe  
 26-28 September 2001  
 QEII Conference Centre, London  
[www.eema.org/isse](http://www.eema.org/isse)  
 e-mail: [isse@eema.org](mailto:isse@eema.org)  
 Telephone +44 (0) 1386 793 028

Standard in der Halbleiterindustrie. Die Struktur eines Chips wird durch ein fotochemisches Verfahren in das Silizium geätzt.

«Intel und seine Partner in der EUV-Limited Liability Corporation (EUV LLC) sehen EUV als den zukünftigen Industriestandard», erklärte Chiang Yang, Direktor von Intels Masks Operation. «Diese Masken dehnen die Lithografie-Technologie auf die nächsten vier Generationen über die gegenwärtige 0,13-Micron-Prozess-Generation aus.» Mit dieser Entwicklung ist kein Ende von Moores Gesetz abzusehen.

Die ersten Beta-Tools für die Prozess-Technologie werden im Jahr 2003 verfügbar sein, bevor die Technologie ab 2005 in die Serienproduktion integriert wird. Intel erwartet, durch den Einsatz von EUV-Technologie die Taktraten von Prozessoren auf 10 GHz hinauftreiben zu können. In bisherigen Produktionsprozessen muss das Licht die Masken passieren, bevor es auf das Silizium trifft. Da EUV von den meisten Materialien absorbiert wird, werden die Masken dazu verwendet, das Licht auf den späteren Chip zu projizieren. Die Masken werden dazu aus mehreren Lagen extrem dünnem Molybdän und Silizium auf einem Trägermaterial aufgebaut. Diese Beschichtung wurde von der Entwicklungsgemeinschaft EUV LLC entwickelt. Die Spiegel sind auf die Wellenlänge von EUV von 13 nm abgestimmt. Die EUV LLC wird die Masken von Intel auf ihrem Teststand verwenden.

Homepage: [www.intel.com](http://www.intel.com)

### Überlastung von Mobilfunknetzen

Wissenschaftler der Universität von Buffalo wollen Nutzungsspitzen in Mobilfunkzellen vermeiden, indem sie Gespräche auf benachbarte Funkzellen mit freien Kapazitäten umleiten. Dazu präsentierten sie das iCAR-System (Integrated Cellular Ad hoc Relay) auf der diesjährigen IEEE International Conference on Communications in Helsinki. Die iCAR-Stationen, die nicht viel grösser als ein Handy sein müssen, können schnurlos und flexibel in bestehenden Funkzellen eingesetzt werden. Ein zusätzlicher Ausbau der Funkkapazitäten mit aufwändigen Stationen auf Dächern oder Kirchtürmen entfällt. Zwar beträgt die Reichweite dieser Systeme nur wenige hundert Meter, doch reicht die Sendestärke aus, um Gespräche auf benachbarte Funkzellen umzuleiten. Automatisch findet die iCAR-Station freie Kapazitäten und baut innerhalb von Millisekunden eine Umleitung aus der überlasteten Funkzelle auf. Das System nutzt dabei eine zusätzliche Funkfrequenz, beispielsweise das unregulierte 2,5 GHz-Band. Doch die Forscher halten es auch für möglich, dass ihr System in andere Netzwerke wie lokale Bluetooth-Netze oder Satellitenverbindungen integriert werden kann. Die Netzbetreiber könnten mit dieser Technik ihre vorhandene Infrastruktur besser auslasten.

Homepage: [www.eng.buffalo.edu](http://www.eng.buffalo.edu)